

株式会社テラプローブ 決算説明会資料

2012年3月期

2012年3月期業績説明

今回の発表の概要

メモリ事業

- DRAM市況の影響から3Q後半より顧客による生産調整のため数量減
- スマートフォン等の生産調整により3Qからテスト時間の長い製品の数量減



前期の投資により能力拡大したが、稼働率が低下し、利益率が低下

今回の発表の概要

システムLSI事業

- SoCは顧客の生産調整等で3Q後半から数量減
- イメージセンサは顧客の生産調整で夏場以降数量減
新規顧客の開拓を継続中
- アナログは安定して受託継続
- 新たに連結子会社テラミクロスにてウエハレベルパッケージ
(WLP)受託開始



**注力分野や新分野の展開あるも、費用先行もあり
赤字解消には至らず**

今回の発表の概要

その他

- 当社筆頭株主であり主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社が会社更生法を申請したことにより、同社向け債権約27億円が回収不能のおそれがあるとして貸倒引当金を計上(特別損失)
- システムLSI事業では投資に対して安定的な稼働が確保できない状況から、固定資産減損損失約54億円を計上(特別損失)
- 熊本県より企業立地協定に基づく補助金約2.6億円交付を受ける(特別利益)
- 連結子会社テラミクロスの資産評価が確定し、負ののれんとして5.6億円を計上(特別利益)



特別損失により当期純損益が大きく減額

2011年度 実績

		連結業績実績比較			(億円)
		FY2010	FY2011	YoY増減	
売上高	メモリ	196.2	197.5	1%	
	システムLSI	17.8	45.3	154%	
	その他	-0.2	-0.8	—	
売上高		213.8	241.9	13%	
営業利益	メモリ	71.2	49.7	-30%	
	システムLSI	-8.7	-10.0	—	
	その他	-10.7	-12.6	—	
営業利益		51.8	27.1	-48%	
営業利益率		24%	11%	—	
当期純損益		41.5	-55.3	—	
当期純利益率		19%	—	—	

※FY2011は3QよりシステムLSI事業にWLPが含まれております

2011年度実績増減分析(売上高)

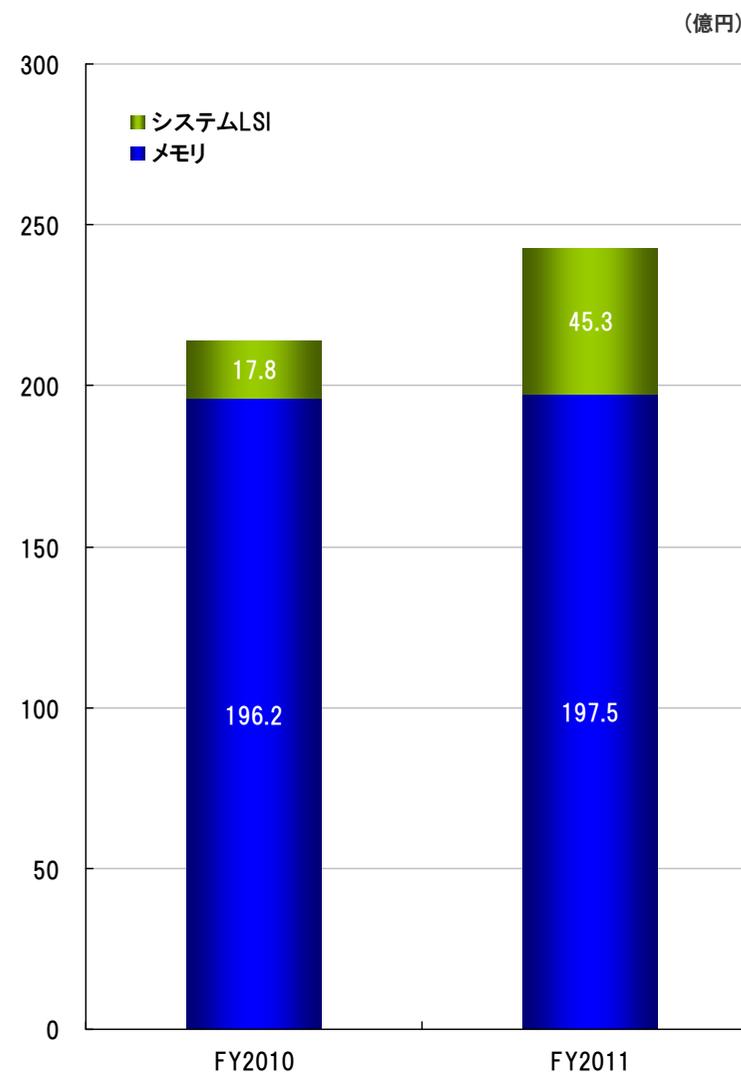
連結売上実績(YoY)

<メモリ事業>

- ・顧客の生産調整の影響があったが、微細化の進行によるテスト時間の増加により横ばい

<システムLSI事業>

- ・WLPの開始により、WLPの売上約28億円増

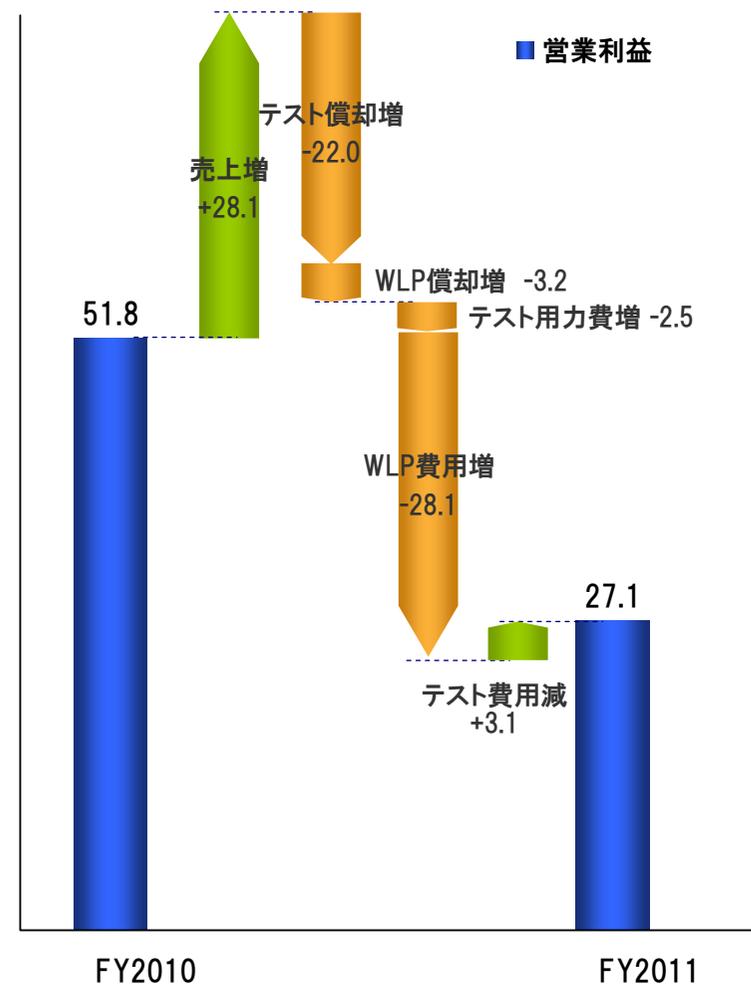


2011年度実績増減分析(営業利益)

(億円)

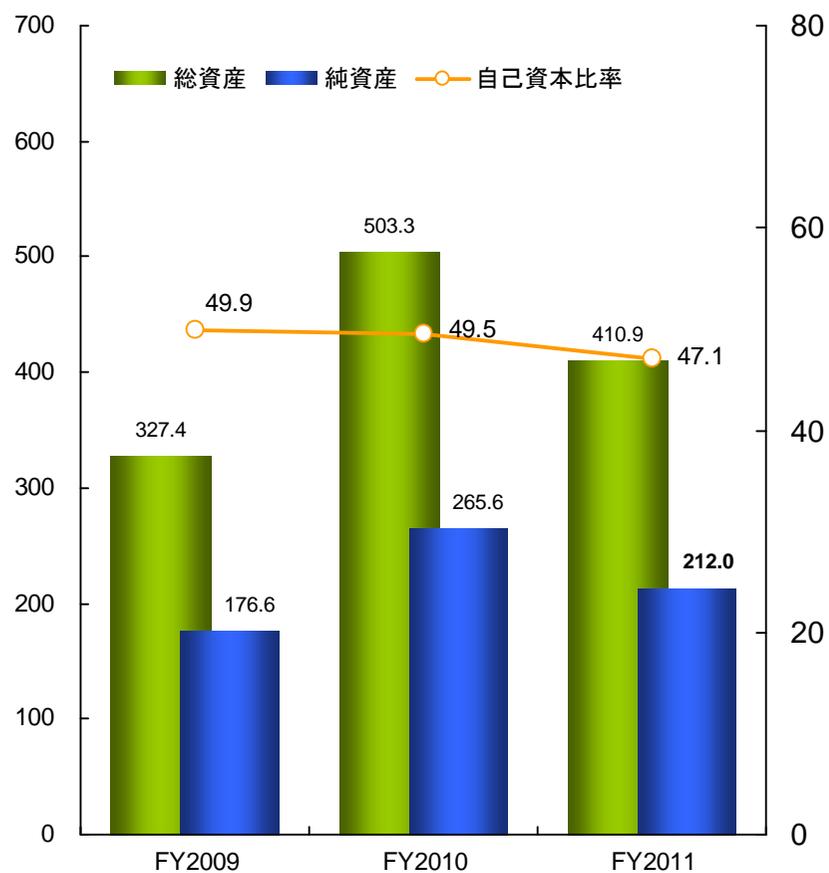
連結営業利益実績(YoY)

- ・WLPの開始により売上約28億円増加するが償却費、費用等が約31億増加
- ・前年度の設備投資による償却費増加等により費用約21億円増

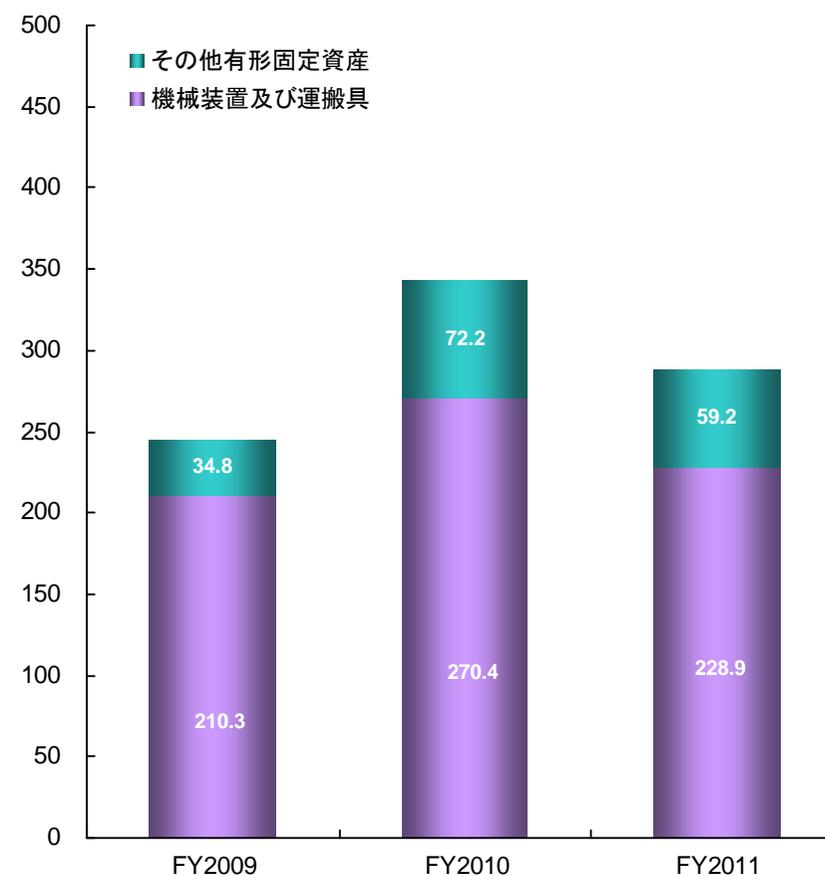


財務状況①

総資産・純資産・自己資本比率



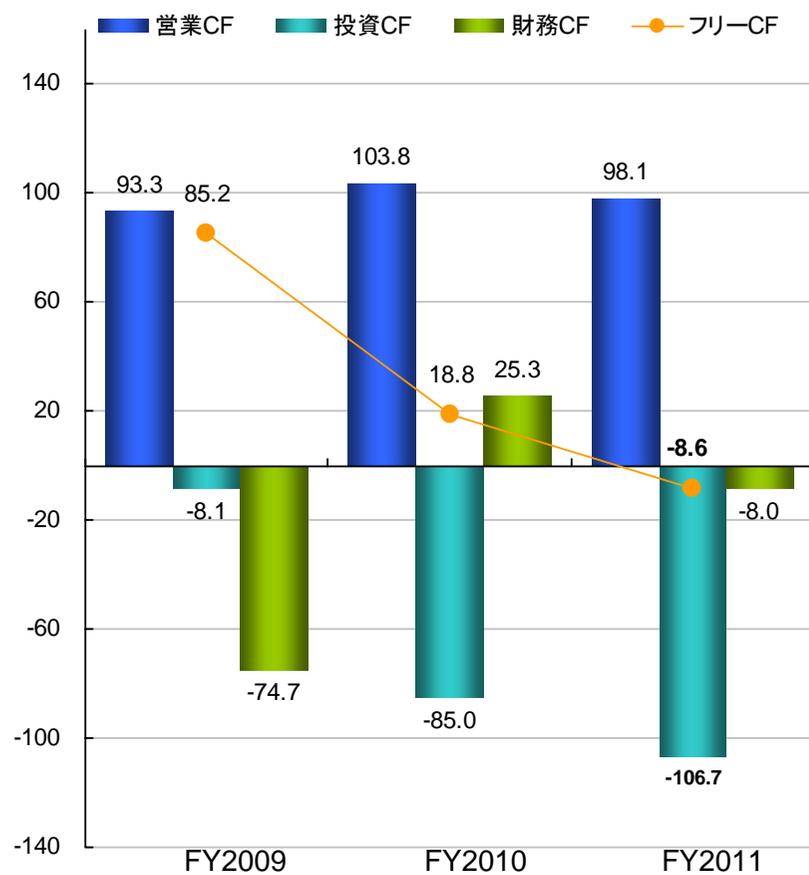
有形固定資産の推移



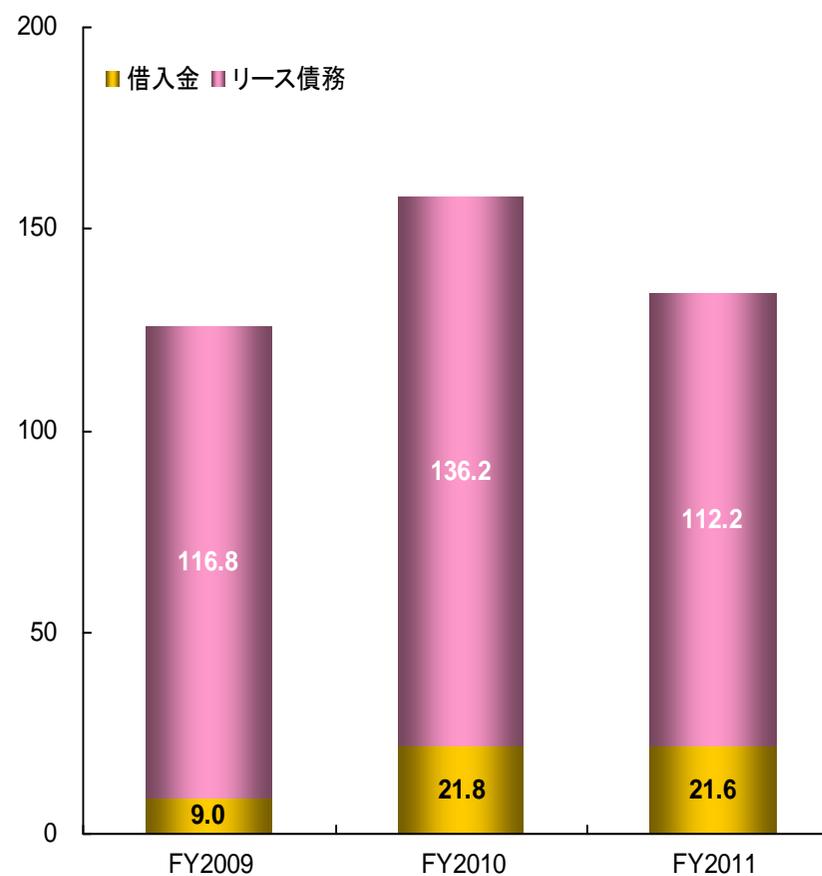
単位:億円

財務状況②

キャッシュフロー



借入金・リース債務残高



単位:億円

2011年度第4四半期 実績

(億円)

		第4四半期連結累計期間実績			四半期連結会計期間実績		
		4Q/FY2010	4Q/FY2011	YoY増減	3Q/FY2011	4Q/FY2011	QoQ増減
	メモリ	52.4	46.1	-12%	48.9	46.1	-6%
	システムLSI	4.6	16.3	256%	18.5	16.3	-12%
	その他	-0.2	-0.1	—	-0.5	-0.1	—
売上高		57.0	62.2	9%	66.9	62.2	-7%
	メモリ	18.7	9.8	-47%	12.1	9.8	-19%
	システムLSI	-2.4	-3.6	—	-2.8	-3.6	—
	その他	-3.1	-3.4	—	-3.6	-3.4	—
営業利益		13.2	2.8	-79%	5.8	2.8	-52%
営業利益率		23%	4%	—	9%	4%	—
当期純利益		15.6	-68.6	—	3.5	-68.6	—
当期純利益率		27%	—	—	5%	—	—

※3Q/FY2011よりシステムLSI事業にWLPが含まれております

第4四半期実績増減分析(売上高)

4Q実績(YoY)

<メモリ事業>

- ・台湾のメモリ製品の市場低迷とDRAMの生産調整により約6億円減

<システムLSI事業>

- ・WLPの売上により約12億円増

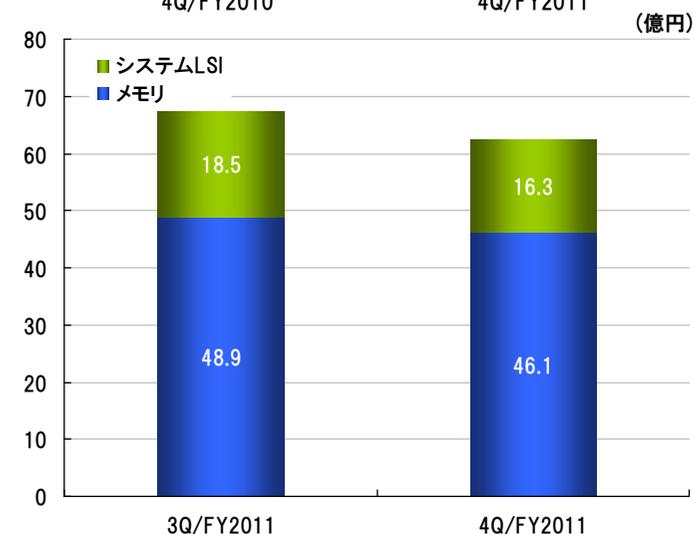
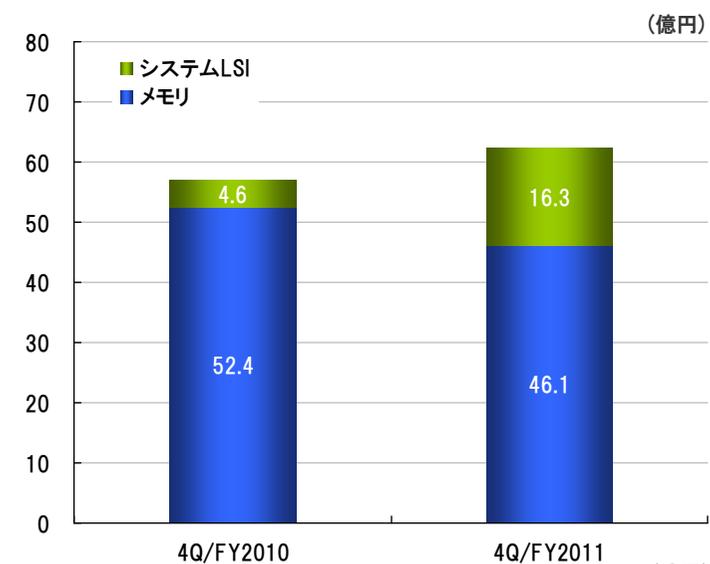
4Q実績(QoQ)

<メモリ事業>

- ・顧客の生産調整等により約3億円減

<システムLSI事業>

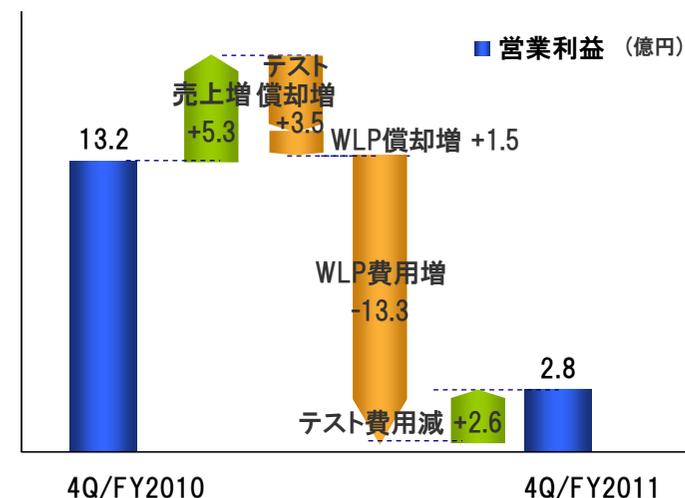
- ・顧客の生産調整等により約2億円減



第4四半期実績増減分析(営業利益)

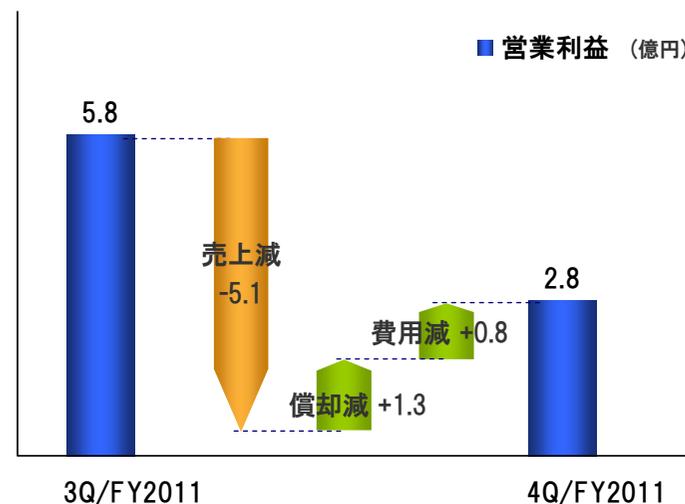
4Q実績(YoY)

- ・DRAMの生産調整があったもののWLPの開始等により売上約5億円増
- ・WLPの開始および前年度の設備投資による償却費増加等により費用約16億円増



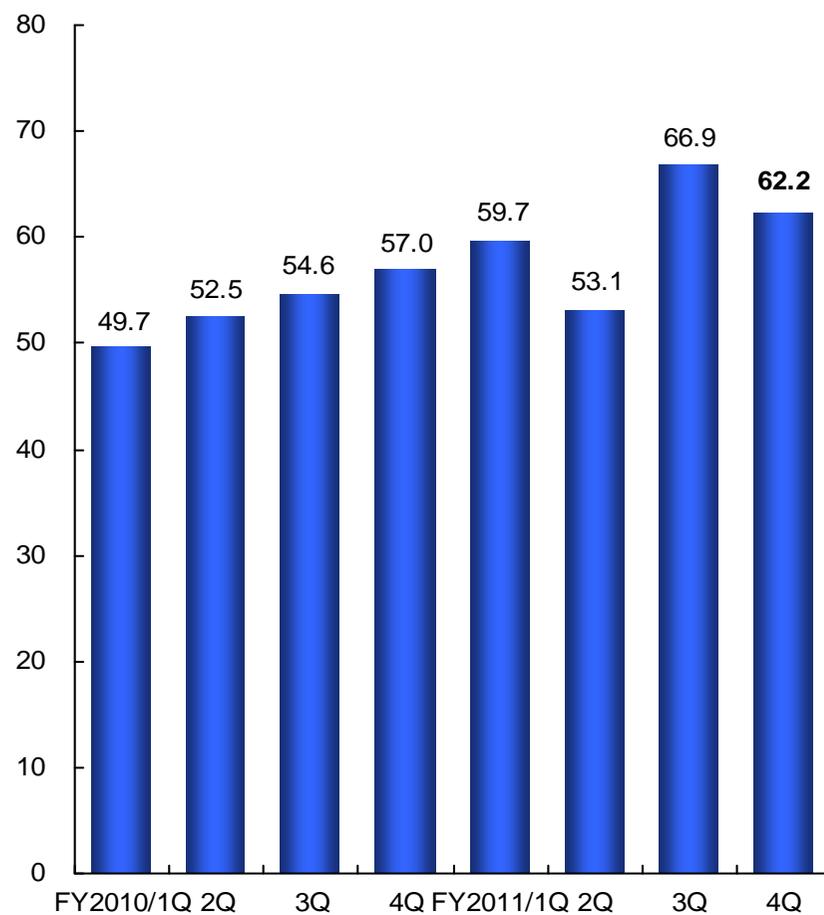
4Q実績(QoQ)

- ・顧客の生産調整等により売上約5億円減
- ・一部設備の償却終了等により償却費、費用約2億円減

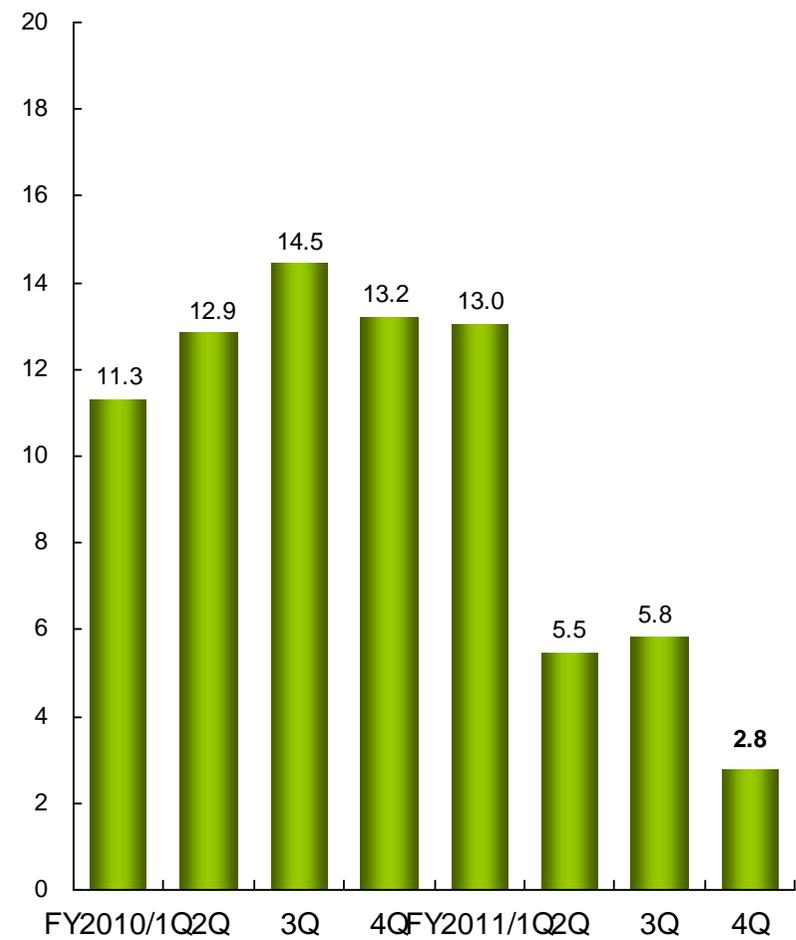


四半期実績の推移

売上高推移



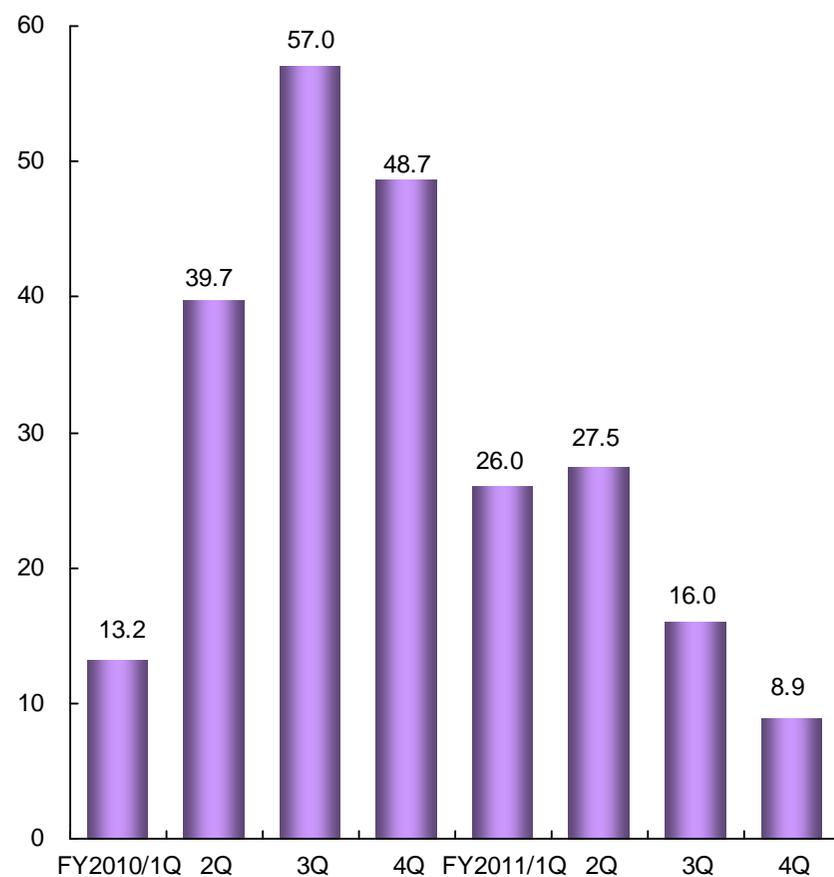
営業利益推移



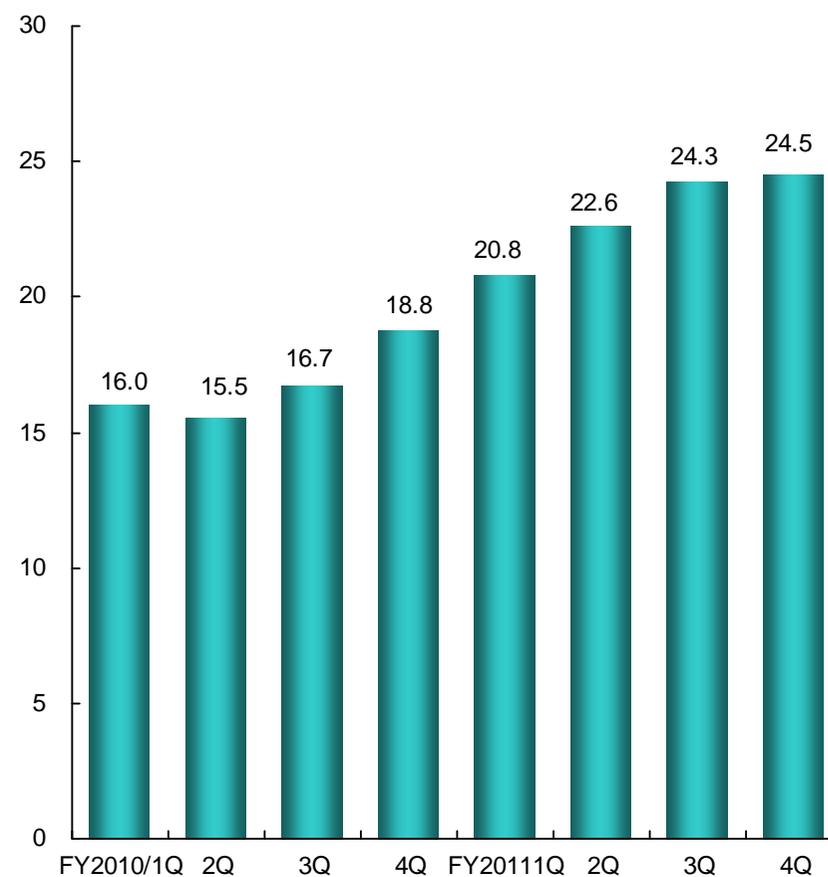
単位: 億円

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



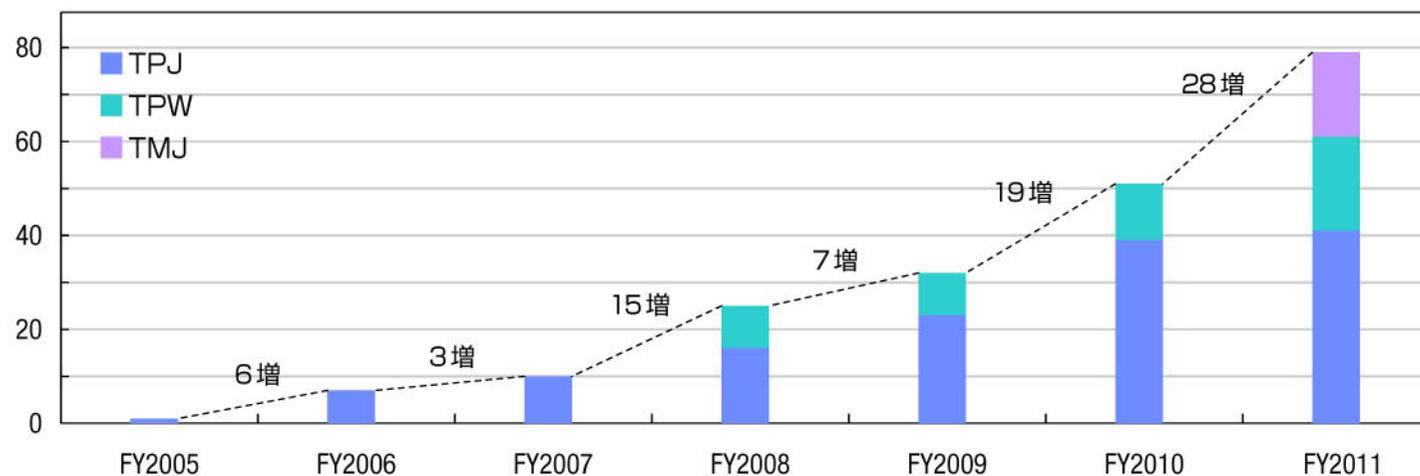
減価償却費推移



単位: 億円

テラプローブの軌跡

顧客数
(累積)

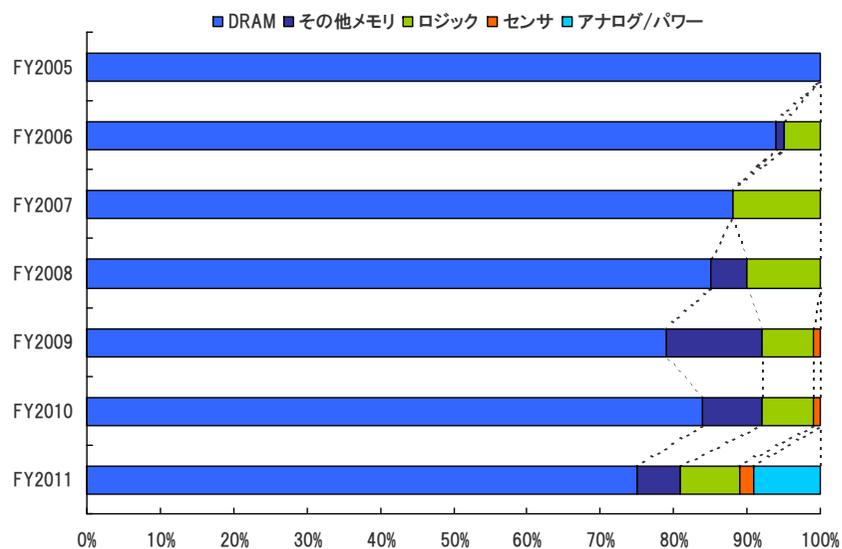


沿革

- 広島事業所にてDRAMのウエハテストを開始
 - 九州事業所開設 ロジック製品のテストを開始
 - 台湾に合併でTeraPowerを設立
台湾でメモリ製品のテストを開始
- テラミクロスがグループに加わり、WLP受託開始

テラプローブの軌跡

品種別売上(%)



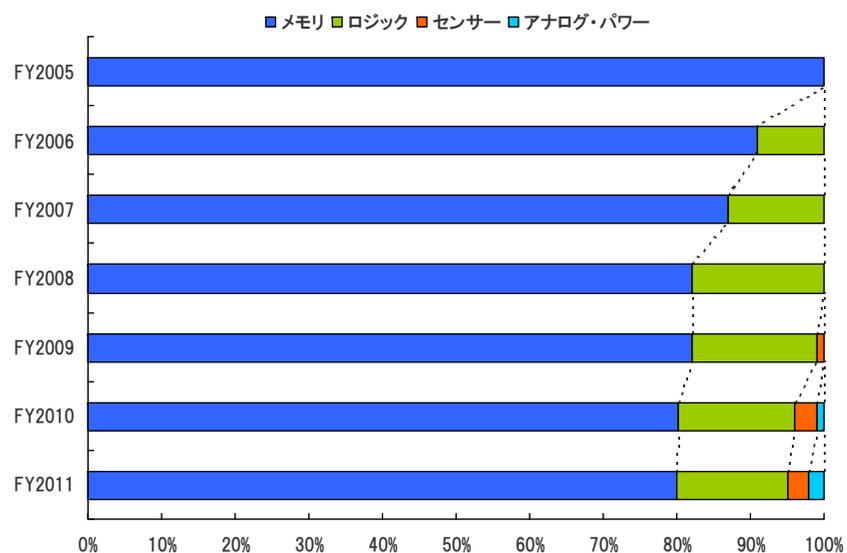
九州事業所でロジック製品のテスト開始

台湾TeraPowerでメモリ製品のテスト開始

九州事業所でイメージセンサのテスト開始

テラミクロスでWLP受託開始

品種別テスト台数(%)



九州事業所でロジック製品のテスト開始

台湾TeraPowerでメモリ製品のテスト開始

九州事業所でイメージセンサのテスト開始

九州事業所でアナログ製品のテスト開始

テラミクロスでWLP受託開始

多数個取り技術でコストダウン実現へ

他分野への挑戦

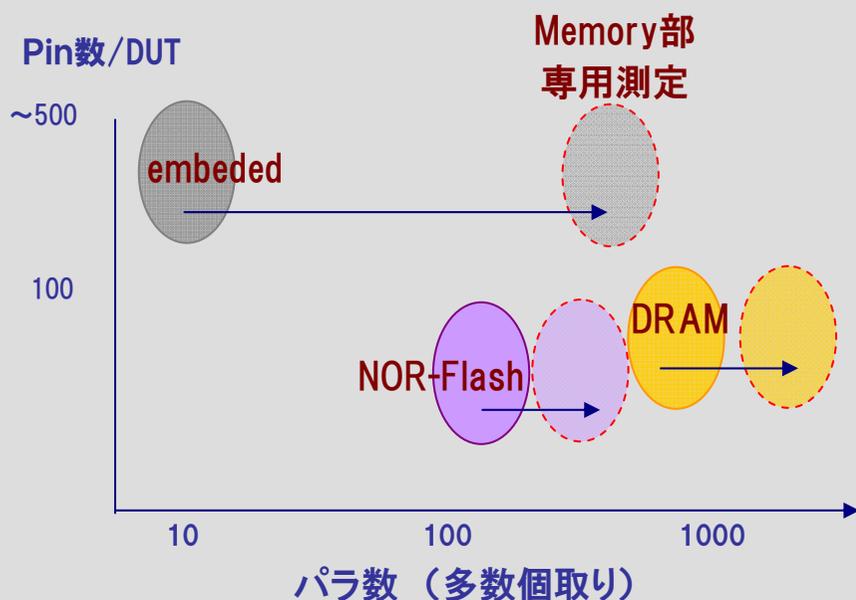
◆DRAMで培った多数個取り技術をベースに
他分野へ展開

- ① embeded(Memory混載Logic)品の多数個測定
- ② Flash Memory 品の測定

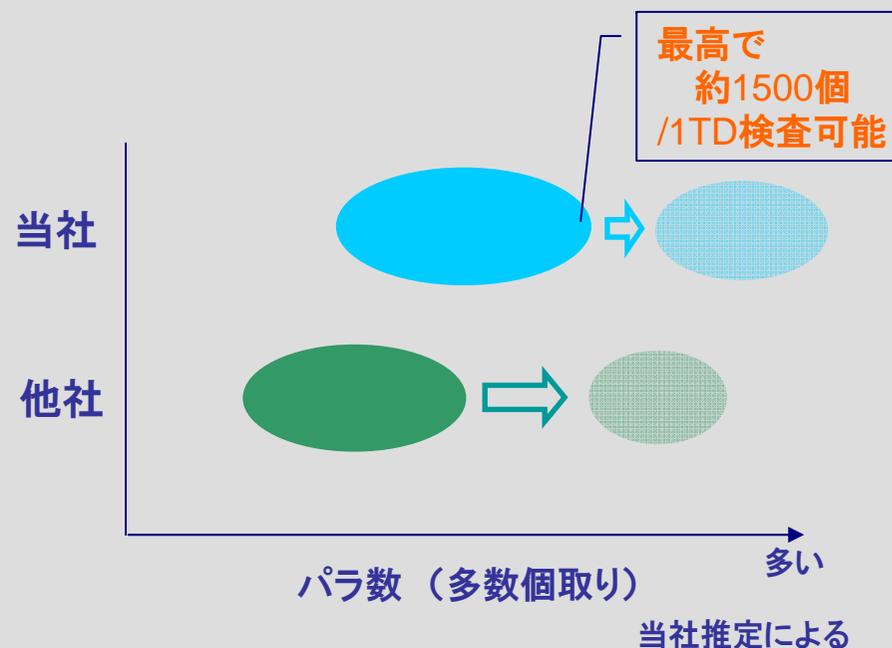
- 多数個取 測定技術
- プローブカード技術
- テストプログラム開発
- 品質向上技術(検出、低針圧PC)
- Low リワークレート、管理技術

システムLSI事業
へ展開

メモリ品状況Pin数 vs パラ数測定



DRAM多数個測定技術



WLP 生産性改善

処理能力 6-8φ 25K枚/月 → 32K枚/月
 12φ 2.3K枚/月 → 3.5K枚/月

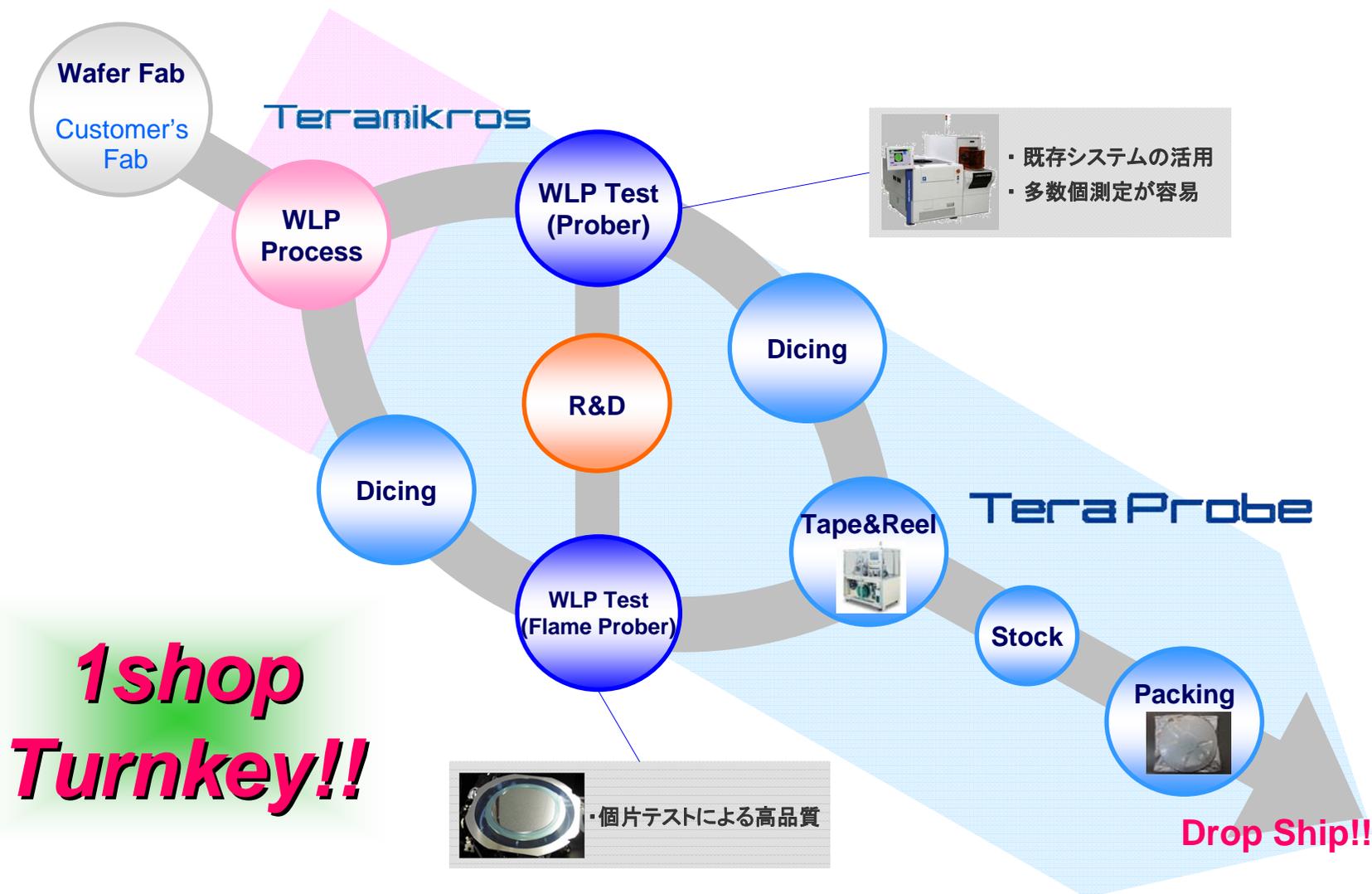
作業分析 →
・段取り時間、待ち時間短縮
・動線改善

工程分析 →
・ボトルネック設備処理時間短縮
・ボトルネック設備稼働率向上
・工程再設計、ロットコントロール



設備投資なしで生産能力を増加

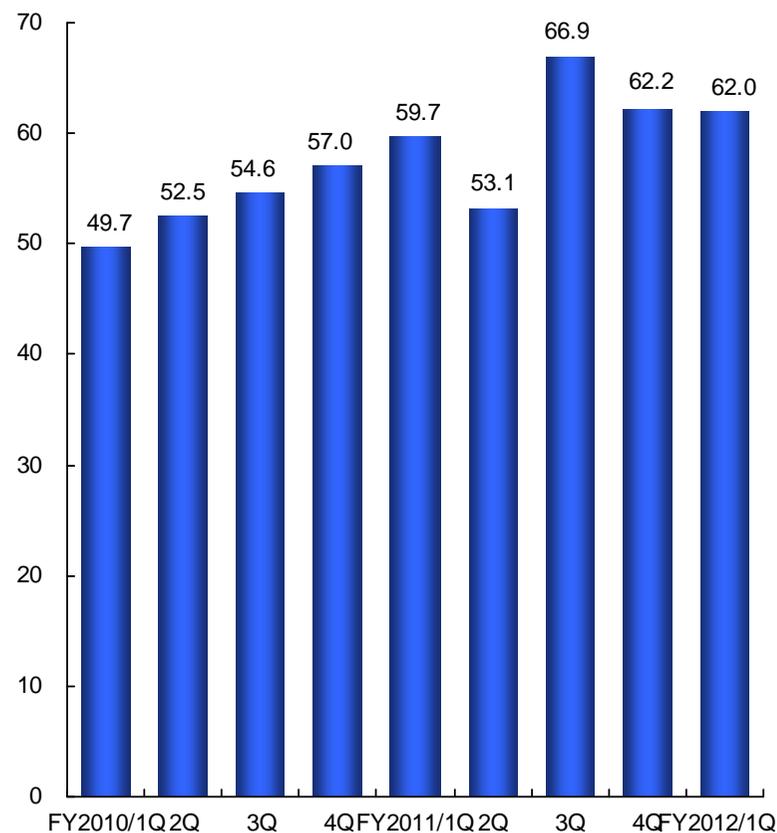
ターンキーの推進



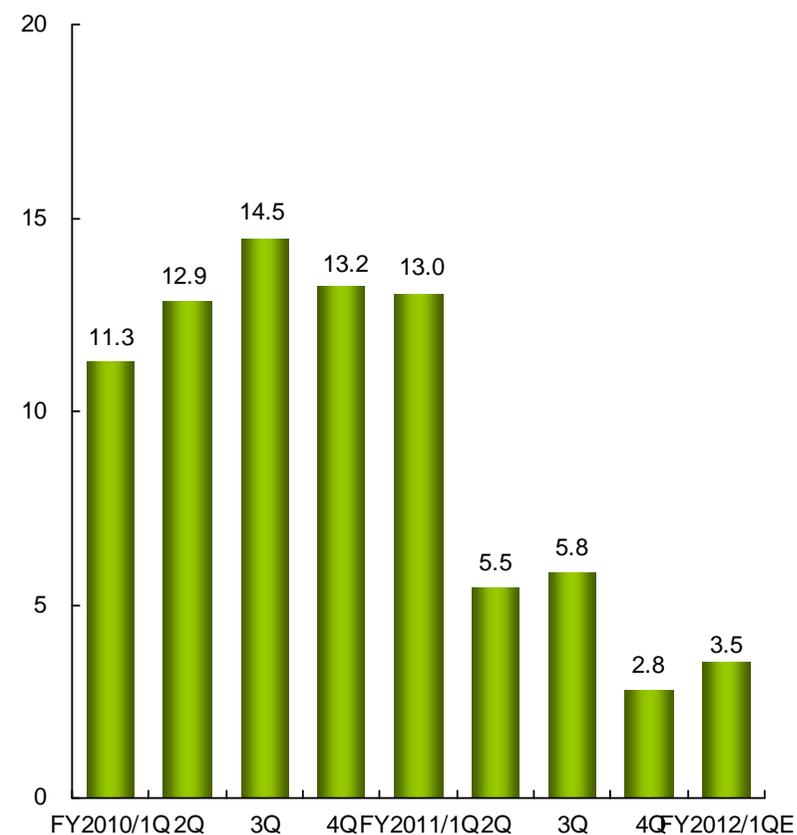
2013年3月期第1四半期業績予想

売上高及び営業利益推移

売上高推移



営業利益推移

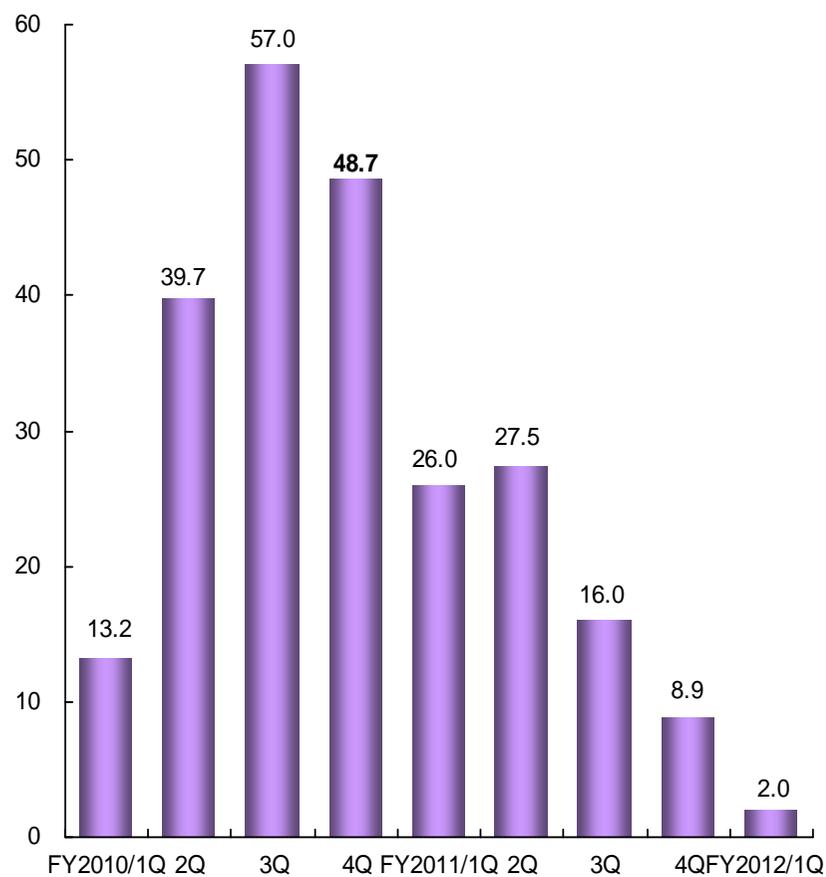


単位: 億円

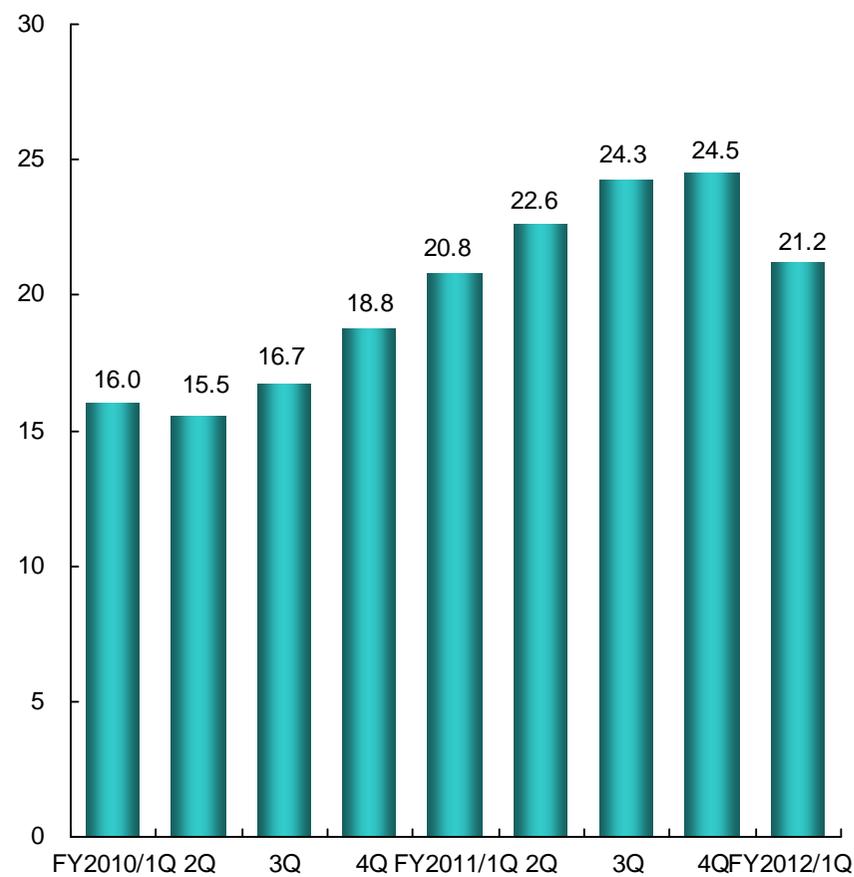
当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



減価償却費推移



単位: 億円

会社説明資料

会社概要

社 名	株式会社 テラプローブ（英文名称:Tera Probe, Inc.）
本 社 所 在 地	神奈川県 横浜市 港北区 新横浜二丁目7番17号
代 表 者	代表取締役会長 越丸 茂 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
設 立	2005年8月
事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、 開発受託及びWLP受託) ・ システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品 のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託)
資 本 金	11,823百万円
連 結 子 会 社	TeraPower Technology Inc.（半導体ウエハテスト受託） 株式会社テラミクロス（ウエハレベルパッケージ受託）
従 業 員 数	294名(単体)、660名(連結)

2012/3末現在

事業拠点

The map shows the locations of Tera Probe's business bases. Red dots indicate the locations: Taiwan (New Taipei City), Hiroshima (Hiroshima City), Kumamoto (Kumamoto City), and several locations in Japan (Yokohama, Aoyama, and Kumamoto). Blue lines connect these dots to detailed information boxes.

海外拠点 (台湾)

TeraPower Technology Inc. (台湾新竹縣)

- 台湾のテスト拠点

国内拠点

本社・開発センター (神奈川県横浜市)

Teramikros (東京都青梅市)

- WLPの生産拠点

九州事業所 (熊本県葦北郡)

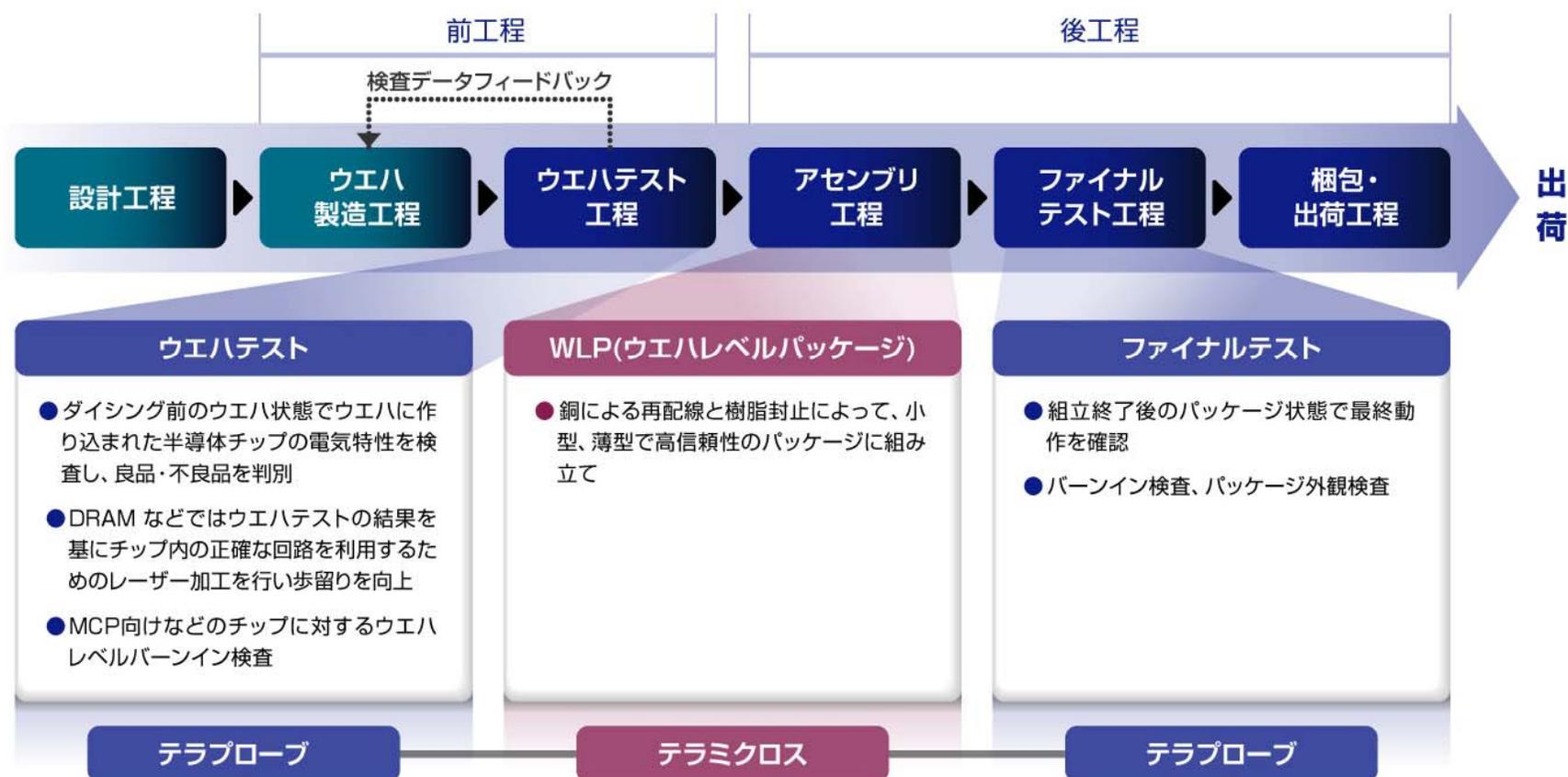
- SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

広島事業所 (広島県東広島市)

- メモリ系のテスト拠点

半導体製造工程における当社事業の役割

- テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで
- 半導体製造のバックエンド（後工程）ターンキーサービスにより、顧客の利便性を向上



バックエンドターンキーサービスとは、顧客がウエハ検査後の全ての工程を一括で委託することで、品質、納期等の管理を一元化できるサービスです。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成24年3月期決算短信」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門

TEL (045)476-5711

URL <http://www.teraprobe.com>